

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【公開番号】特開2009-105361(P2009-105361A)

【公開日】平成21年5月14日(2009.5.14)

【年通号数】公開・登録公報2009-019

【出願番号】特願2008-26731(P2008-26731)

【国際特許分類】

H 05 K	1/14	(2006.01)
C 09 J	201/00	(2006.01)
C 09 J	11/06	(2006.01)
C 09 J	9/02	(2006.01)
H 01 B	1/22	(2006.01)
H 05 K	3/36	(2006.01)
C 09 J	7/02	(2006.01)
C 09 J	7/00	(2006.01)

【F I】

H 05 K	1/14	H
C 09 J	201/00	
C 09 J	11/06	
C 09 J	9/02	
H 01 B	1/22	D
H 05 K	3/36	A
C 09 J	7/02	Z
C 09 J	7/00	

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第一の基板の主面上に第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、第二の基板の主面上に第二の回路電極が形成された第二の回路部材とを、前記第一の回路電極と前記第二の回路電極とを対向させた状態で接続するための回路接続材料であって、

光の最大吸収波長が800～1200nmの範囲内にある近赤外線吸収色素を含む接着剤組成物を有し、前記近赤外線吸収色素がフタロシアニン系化合物である、回路接続材料。

【請求項2】

前記接着剤組成物の樹脂固形分全体に対する前記近赤外線吸収色素の含有量が0.1～1.0質量%である請求項1記載の回路接続材料。

【請求項3】

前記接着剤組成物が導電粒子を含有する請求項1又は2に記載の回路接続材料。

【請求項4】

前記接着剤組成物がフィルム形成性高分子を含有する請求項1～3のいずれか一項に記載の回路接続材料。

【請求項 5】

第一の基板の主面上に第一の回路電極が形成された第一の回路部材と、

第二の基板の主面上に第二の回路電極が形成され、前記第二の回路電極と前記第一の回路電極とが対向するように配置された第二の回路部材と、

前記第一の基板と前記第二の基板との間に設けられ、前記第一の回路部材と前記第二の回路部材とを接続する回路接続部と、を備える接続構造体であって、

前記回路接続部が、請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の回路接続材料に近赤外線領域の光を照射することにより前記接着剤組成物を硬化させた樹脂硬化物を含む接続構造体。

【請求項 6】

前記第一の回路部材及び前記第二の回路部材の少なくとも一方は、波長 800 ~ 1200 nm の光の分光透過率が 50 % 以上である、請求項 5 記載の接続構造体。

【請求項 7】

第一の基板の主面上に第一の回路電極が形成された第一の回路部材と第二の基板の主面上に第二の回路電極が形成された第二の回路部材とを、前記第一の回路電極及び前記第二の回路電極が対向するように配置し、これらの間に請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の回路接続材料を介在させて、前記第一の回路部材及び前記第二の回路部材と前記回路接続材料とを密着させた状態で近赤外線領域の光を照射して前記回路接続材料の前記接着剤組成物を硬化させることにより、前記第一の回路部材と前記第二の回路部材とを接続する工程を備える接続構造体の製造方法。

【請求項 8】

前記第一の回路部材及び前記第二の回路部材の少なくとも一方は、波長 800 ~ 1200 nm の光の分光透過率が 50 % 以上である、請求項 7 記載の製造方法。